



2017年12月期 決算・中期経営計画説明資料

株式会社RS Technologies



東証一部
3445

目次

会社概要 P.3

会社概要

沿革

現在のRS Technologies

代表取締役方永義の強み

中期経営計画 P.8

RS Technologiesの目指す世界

再生ウェーハビジネス（1）

再生ウェーハビジネス（2）

プライムウェーハビジネスに進出

中国の半導体政策

設備投資計画・事業計画

中期経営計画の概要

業績動向 P.16

2017年度決算概要

セグメント別動向

営業利益増減要因分析

財務諸表

2018年度見通し

中長期経営方針

Appendix P.23

業績推移

主要財務諸表

会社概要

半導体再生ウェーハで市場シェア3割のトップ企業。中国でのプライムウェーハ事業への参入により、再生ウェーハ専業からプライムウェーハメーカーへ業容拡大

社名	株式会社RS Technologies
設立	2010年12月10日
経営理念	「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する。」
事業内容	電子材料、電子機器部品、通信機器部品材料の製造、加工、再生、販売 太陽光発電事業。中古半導体設備の買取及び販売事業。半導体材料・パーツの販売。半導体シリコンウェーハ製造の技術コンサルティング。
本社所在地	東京都品川区大井1-47-1 NTビル 12F
三本木工場	宮城県大崎市三本木音無字山崎26-2
資本金	641,850千円（2017年12月末時点）
代表取締役	方 永義
従業員数	600人（2017年12月末時点 正社員443人派遣社員157人）
連結子会社	艾爾斯半導体股份有限公司（台湾）2014年2月設立 資本金 NT \$300 million 北京有研RS半導体科技有限公司（北京）2018年1月設立 登録資本 US \$138 million



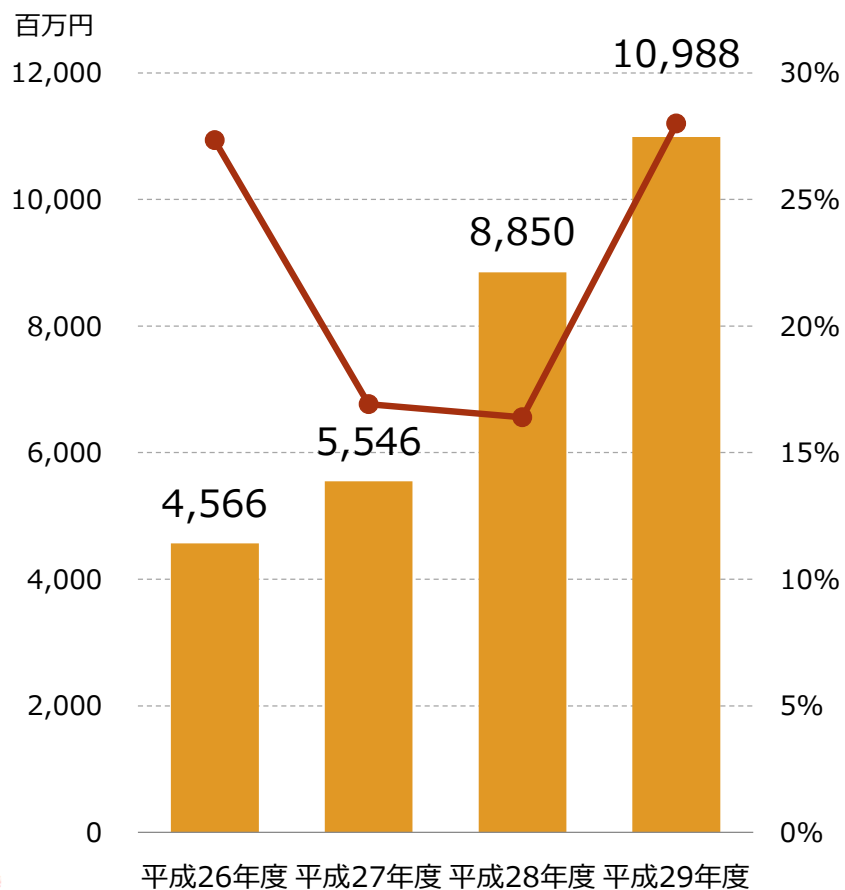
ラサ工業のシリコンウェーハの再生事業を承継し、2010年に創業。再生ウェーハ事業で世界トップ。2015年に東証マザーズに上場、2016年に東証一部に。2018年中国の大手プライムウェーハメーカーを連結子会社化へ

2010年（平成22年）12月	東京都品川区において、シリコンウェーハ再生事業（1884年1月よりラサ工業で事業展開）を主たる事業として株式会社 RS Technologiesを設立
2011年（平成23年）1月	三本木工場において操業開始（ラサ工業株式会社を退職した従業員の一部を雇用）
2011年（平成23年）11月	三本木工場がUKASより「ISO9001:2008」（品質マネジメントシステム）認証取得
2013年（平成25年）3月	機械販売事業開始
2013年（平成25年）10月	三本木工場においてソーラー事業を開始
2014年（平成26年）2月	台湾に子会社として艾爾斯半導體股份有限公司（現・連結子会社）を設立
2015年（平成27年）3月	東京証券取引所マザーズに株式を上場
2015年（平成27年）6月	最先端設備（450mmウェーハ再生可能）を導入した三本木工場・第8工場が竣工
2015年（平成27年）10月	第13回「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジー Fast50」において成長率1299.53%を記録し3位受賞
2015年（平成27年）12月	艾爾斯半導體股份有限公司（現・連結子会社）の台南工場が竣工
2016年（平成28年）9月	東京証券取引所市場第一部（東証一部）へ市場変更
2017年（平成29年）12月	北京有色金属研究総院及び福建倉元投資有限公司と三社間で合併契約を締結
2018年（平成30年）1月	北京有研RS半導体科技有限公司を設立、中国プライムウェーハ製造メーカーである有研半導体材料有限公司を連結子会社化
2018年（平成30年）5月	株式会社ユニオンエレクトロニクスの株式取得予定

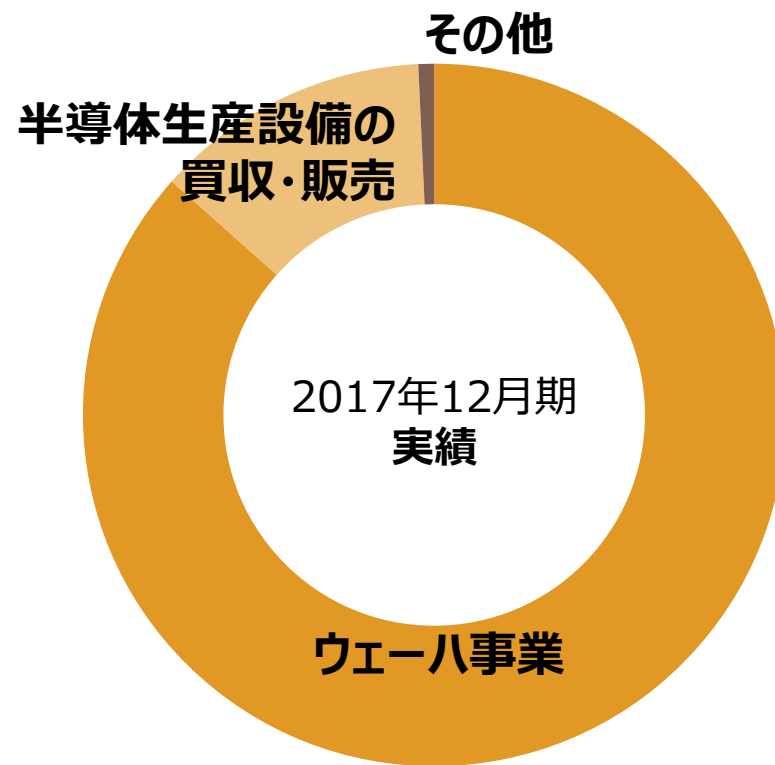
現在のRS Technologies

再生ウェーハ中心のウェーハ事業が売上の5分の4。そのほか中国向け中心の半導体生産設備の買取・販売、ソーラー事業などを展開

連結売上高および営業利益率



セグメント別業績



代表取締役 方永義の強み

代表取締役社長である**方永義**が20年以上にわたって日本で培った知見と自身が持つネットワークを生かした全世界への販売力・人脈力・提携力・資金力が強み。
方永義の下にハイテクや金融など幅広い分野のプロフェッショナル人財が集結。



方永義は 前列中央（2016年9月、東京証券取引所にて撮影）

方 永義（ほう ながよし）

1970年生まれ 中国福建省出身
城西国際大学院 修了

得意分野：
M & A、業務提携（過去10社を超えるM & Aを成功）

1998年 永輝商事設立
2006年 永輝商事社長就任
2010年 当社設立社長就任（現任）

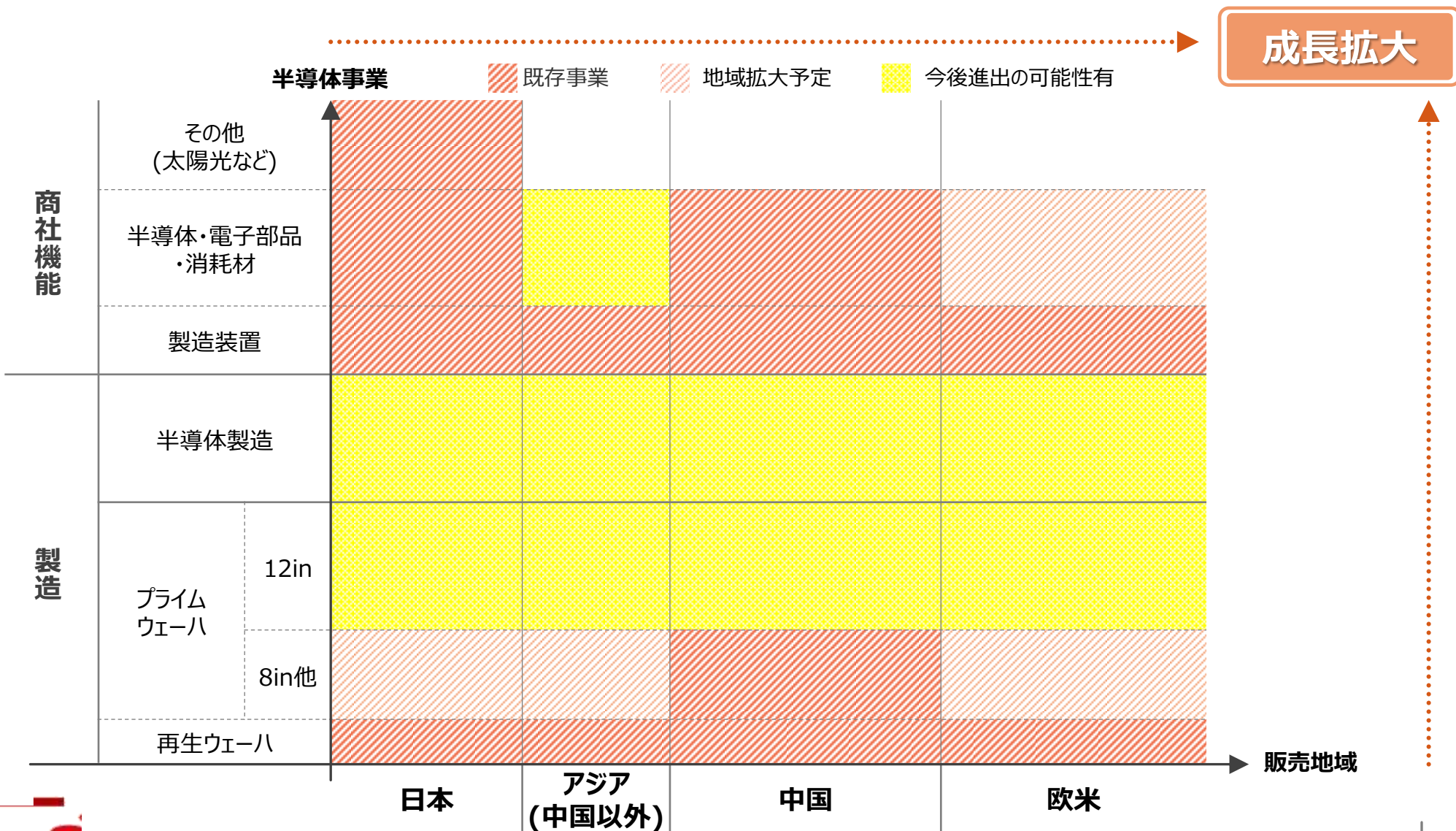
大切にしている心：**為せば成る**

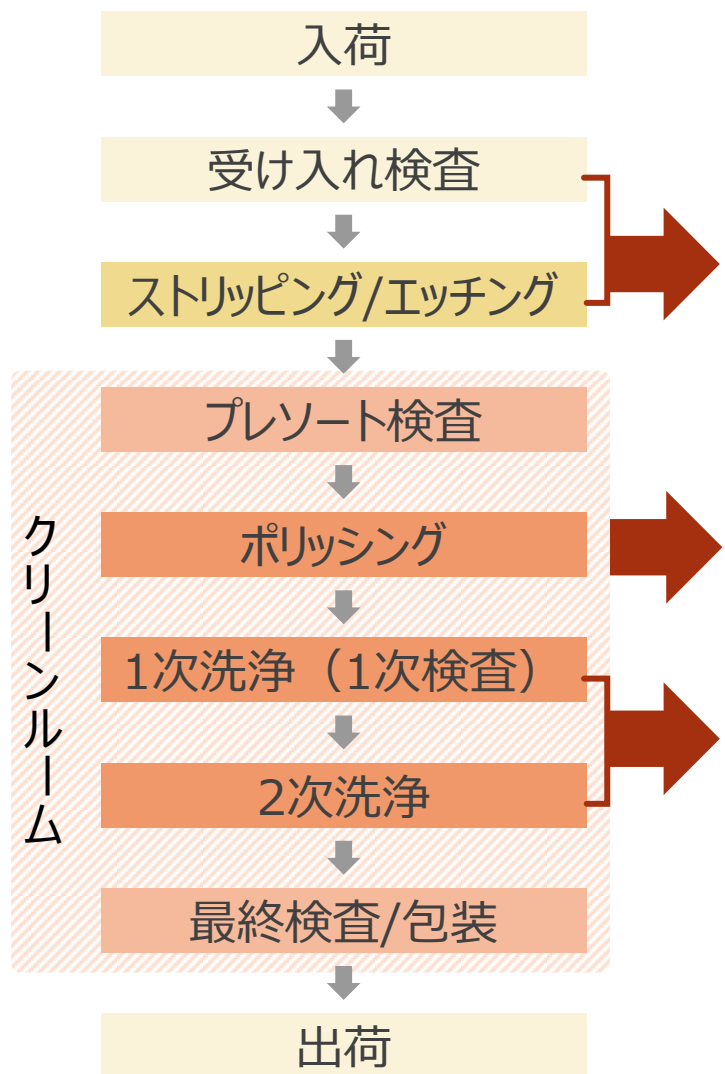
補足：
高校卒業後に来日。日本国内外で20以上の会社の投資経験。「半導体事業」の他、ファンドや貿易、ホテル、IT事業、農業等様々な業界の投資を経験。「日本のものづくりは世界一」との信条の元、それを世界に広めていくため、世界中を飛び回っている。

中期経営計画

RS Technologiesの目指す世界

一歩一歩と着実に事業領域と販売地域を広げている





強み 1

すべての膜を剥離可能

- ケミカルによる除去の為、表面のダメージが最小限に

▶ 再生回数が多い ▶ よりコストダウンが可能

ラサ工業（化学）の特異技術を継承



表面に付いているキズや凹凸を研磨（ポリッシング）により平滑にする

強み 2

金属不純物を除去

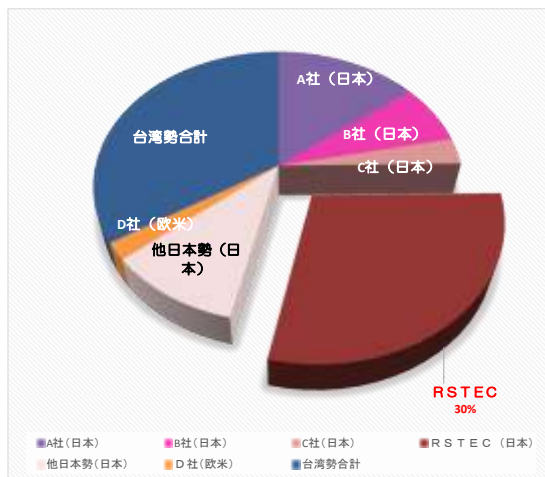
- ウェーハ表面の微細ゴミ・汚れを洗浄で取り除く
- + 金属不純物を除去 特に銅 (Cu) の除染除去に強み



再生ウェーハビジネス(2)

再生市場での当社のシェア拡大

300mm再生市場における当社シェア



台湾の新設・三本木の増設により、生産能力が増加、現在のシェアは30%に上昇

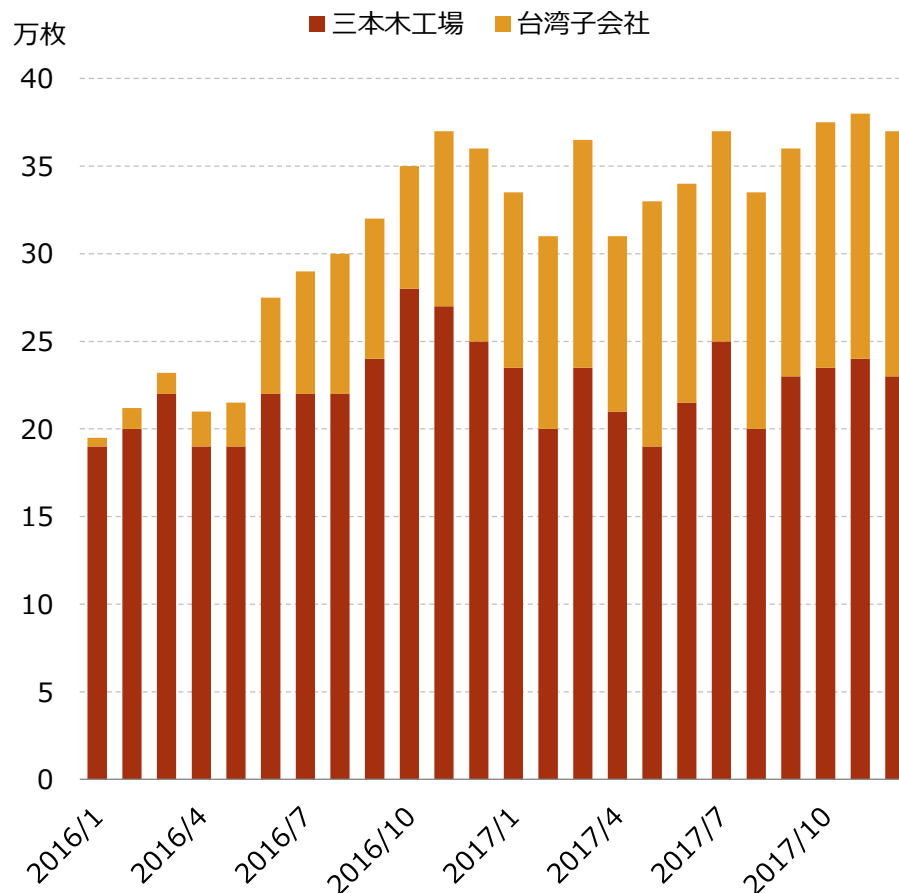
両工場の既存設備によるさらなる生産力のアップ、三本木の空工場利用、業務提携・M&A等の手法を用いて

**2018年に40%
にシェアを拡大**

	2015年 上期	2015年 下期	2016年	2017年	2018年 目標
当社グループ 生産能力	18万枚	24万枚	28万枚	30万枚	≥40% 目標
当社グループ シェア	19%	24%	29%	30%	

三本木工場と台湾子会社の出荷推移

三本木工場と台湾子会社の300mmウェーハ出荷枚数推移



プライムウェーハビジネスに進出

中国中央政府直属企業の北京有色金属研究総院（現 有研科技集团有限公司）との合併会社を設立。内資企業（中国の国内企業）として半導体事業を推進



当社と有研とのシナジー効果

強み1

中国国内での販売に際し内資企業としての優位性

強み2

中国半導体施策の恩恵を享受

強み3

RSのグローバルな販売網で全世界顧客へ販売

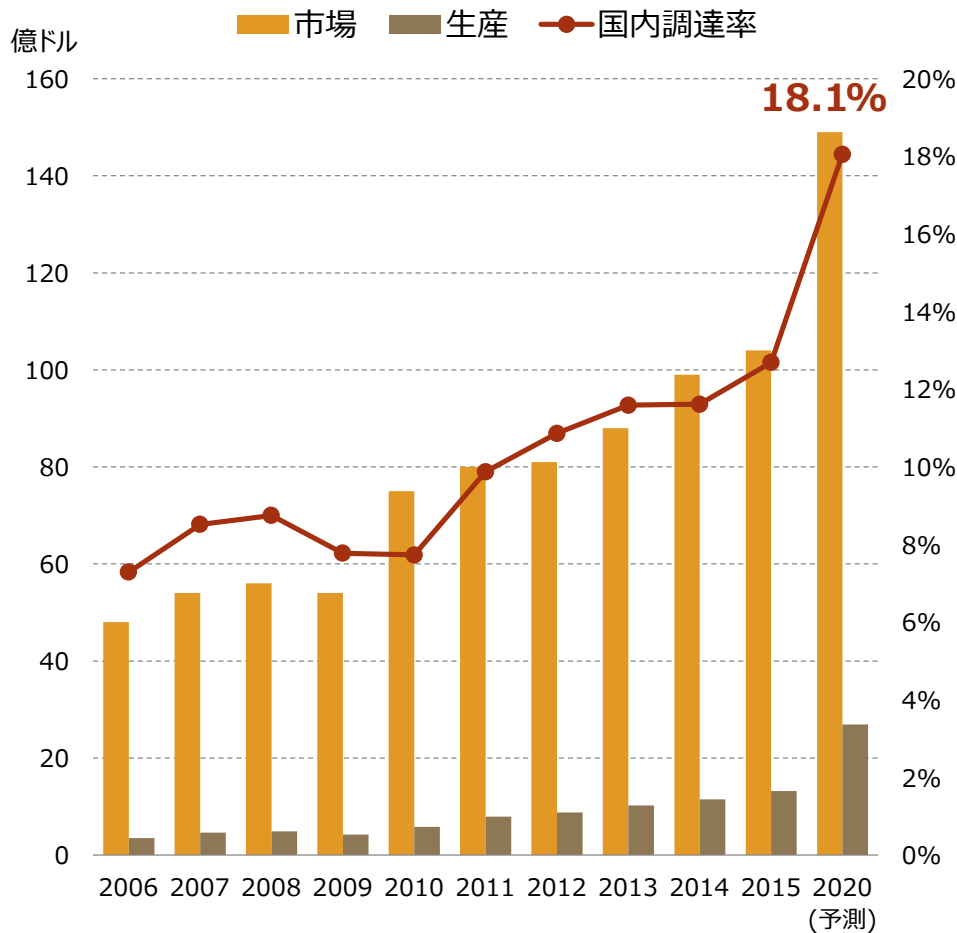
強み4

RSの再生加工技術を活用

- 30年以上に及び当社の知見・見識あり

中国の半導体政策：国産化率のアップを目指す

中国における半導体市場および生産動向



中国の半導体消費は世界の4割を占めるまで成長
一方、国産化率はその内10%程度



国産化率の引き上げが**重要な政策課題**に

2014年6月

「**国家集成电路産業発展推進綱要**」

(国家IC産業発展推進ガイドライン)

2015年5月

「**中国製造2025**」

<以下引用> (メイド・イン・チャイナ2025)

China is aiming to improve the self-sufficiency rate for ICs in the nation to **40% in 2020**, and boost the rate further to **70% in 2025**.



目標は、

2020年に国産化率**40%**、2025年に**70%**

設備投資計画、事業計画

日本

総投資額： 4億円

- 300mm再生ウェーハの生産能力拡充
- 2019年稼働開始

2018年度

2019年度

2020年度

4億円

台湾

総投資額： 7億円

- 300mm再生ウェーハの生産能力拡充
- 2019年稼働開始

2018年度

2019年度

2020年度

7億円

北京

総投資額： 94億円

- 200mmプライムウェーハの生産能力拡充

2018年度

2019年度

2020年度

42億円

52億円

-億円

中国半導体政策
の恩恵

- 1.新設工場敷地取得の際の補助金。
- 2.工場建設資金の提供。
- 3.総投資金額の一定の比率の補助金。
- 4.有利子負債利息への補助金。
- 5.製造したプライムウェーハの中国国内優先販売。

第1次計画

200mmプライム
ウェーハ

2018年
5万枚

2021年
20万枚

投資期間 2019年～2020年 2020年より順次稼働開始



中計（4か年）計画の概要

再生ウェーハメーカーからプライムウェーハメーカーへ業容拡大

最終年度（2021年）に目指す姿

中国半導体市場におけるシリコンウェーハのリーディングカンパニー

再生ウェーハ市場での盤石な地位確保

(百万円)	2017年12月期 実績	2018年12月期 計画	2019年12月期 計画	2020年12月期 計画	2021年12月期 計画
売上高	10,988	20,993	21,000	25,000	29,000
営業利益	3,075	3,891	3,600	4,800	6,300
営業利益率	28.0%	18.5%	17.1%	19.2%	21.7%
経常利益	3,223	3,897	3,900	4,700	6,200
経常利益率	29.3%	18.6%	18.6%	18.8%	21.3%
親会社株主に帰属 する当期純利益	2,210	2,585	2,500	2,900	3,800
一株当たり 当期純利益（円）	199.31	208	201	233	306

※シリコンウェーハの販売単価は、2018年期初単価を据え置いております。

※半導体生産設備の買取・販売事業について2018年、2019年は売上を見込んでおりますが、2020年以降は織り込んでおりません。

※一株当たり当期純利益は2018年3月6日発行決議による公募増資分は含んでおりますが、O.A分は含んでおりません。



業績動向

2017年度決算概要

再生ウェーハ市場をめぐる事業環境は、半導体（FoundryやMemory）及び、シリコンウェーハの需給ひっ迫で、好調に推移。
当社の事業環境も総じて堅調。

(百万円)	2016年12月期 (2016年1月～12月)	2017年12月期 改定予算 (2017年1月～12月)	2017年12月期 (2017年1月～12月)	前期比	達成率
売上高	8,849	9,450	10,988	124.2%	116.3%
営業利益	1,557	2,550	3,075	197.4%	120.6%
営業利益率	17.6%	26.9%	28.0%		
経常利益	1,450	2,650	3,223	222.2%	121.6%
経常利益率	16.3%	28.0%	29.3%		
親会社株主に 帰属する 当期純利益	869	1,630	2,210	254.1%	135.6%
一株当たり当 期純利益	79.98円	145.87円	199.31円	+119.33円	136.6%

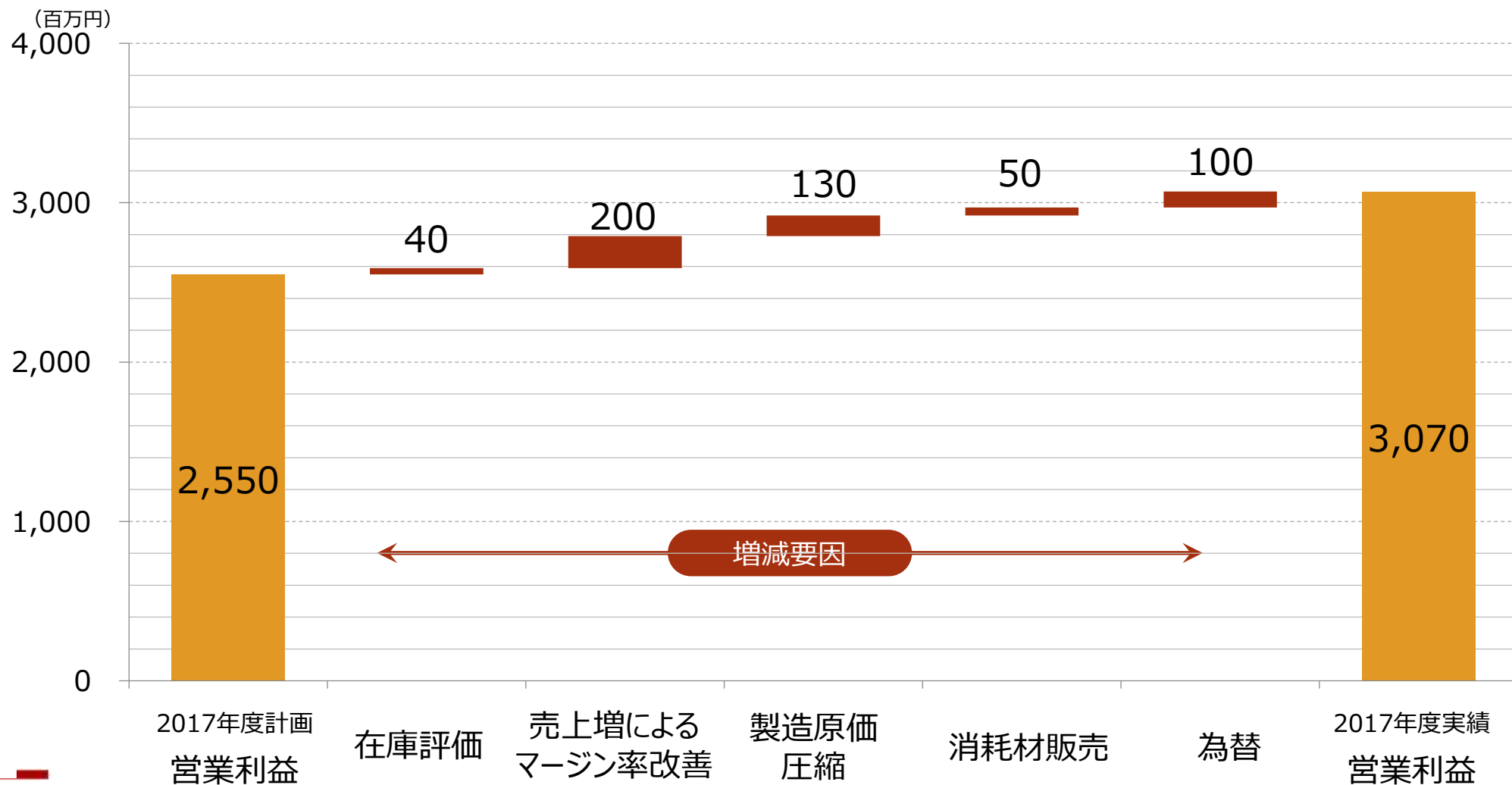
2017年度セグメント及び会社別動向

セグメント別 (百万円)	ウェーハ事業	半導体生産設備 の買収・販売	その他	連結合計
売上高	9,513	1,395	79	10,988
営業利益	3,461	129	△516	3,075
営業利益率	36.4%	9.2%	—	28.0%

会社別 (百万円)	RS	台湾子会社	連結消去	連結合計
売上高	8,503	2,647	△162	10,988
営業利益	2,139	885	50	3,075
営業利益率	25.2%	33.5%	—	28.0%

営業利益増減要因分析

- 一部顧客で単価が上昇したことによるマージン率の改善効果。
- 為替も当初計画（1USD=107円）より円安に進んだことで利益に寄与。



財務諸表

連結貸借対照表

(百万円)	2016年12月期	2017年12月期
資産の部		
流動資産	5,525	7,625
現金及び預金	1,952	3,243
受取手形及び売掛金	2,727	3,141
商品及び製品	361	463
固定資産	5,333	4,843
有形固定資産	5,152	4,674
無形固定資産	23	19
投資その他資産	158	149
資産合計	10,859	12,468
負債の部		
流動負債	3,000	3,384
支払手形及び買掛金	283	398
有利子負債	1,537	1,275
固定負債	4,317	3,291
長期借入金	3,620	2,767
負債合計	7,317	6,676
純資産の部		
純資産	3,541	5,792
負債・純資産合計	10,859	12,468

キャッシュ・フロー

(百万円)	2016年12月期	2017年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	964	2,744
投資活動によるキャッシュ・フロー	△776	△202
財務活動によるキャッシュ・フロー	△91	△1,252
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	△87
現金及び現金同等物の増減額	110	1,201
現金及び現金同等物の期首残高	1,603	1,714
現金及び現金同等物の期末残高	1,714	2,916

2018年度見通し

中国でのプライムウェーハ事業（有研半導体材料有限公司）が寄与することで、大幅増収。利益率は、再生事業よりプライム事業が相対的に低いことから、前期比でマイナスとなる見込み。

(百万円)	2017年12月期 実績 (2017年1月～12月)	2018年12月期 予想 (2018年1月～12月)	前期比
売上高	10,988	20,993	+10,005
営業利益	3,075	3,891	+816
営業利益率	28.0%	18.5%	△9.5%
経常利益	3,223	3,897	+674
経常利益率	29.3%	18.6%	△10.7%
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,210	2,585	+375
一株当たり当期純利益	199.31円	208.00円	+8.69円
年間配当金	5円	未定	—

為替前提

2017年12月期 実績 1 USD = 113円。1 台湾ドル = 3.7円。

2018年12月期 予算 1 USD = 111円。1 台湾ドル = 3.5円。1 人民元 = 17円。



1. 再生ウェーハ市場での当社のシェア拡大

- ①.生産キャパシティの拡大
- ②.伸長する需要の取り込み
- ③.潜在的な再生市場の開拓

2. 中国半導体マーケットへの参入

- ①.200mmプライムウェーハの生産力拡大
- ②.300mmプライムウェーハへの参入
- ③.ターゲット材（半導体部材）の中国進出
- ④.半導体生産設備及び関連資材の中国販売拡大

Appendix

長期データの提供

業績推移

(百万円)	2012年12月期	2013年12月期	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期
売上高	1,433	3,475	4,566	5,545	8,849	10,988
売上総利益	156	1,173	1,820	1,872	2,516	4,345
販管費	186	471	654	791	958	1,269
営業利益	△31	703	1,166	1,081	1,557	3,075
経常利益	44	819	1,247	937	1,450	3,223
当期利益	50	525	664	304	869	2,210
設備投資	32	347	2,901	4,538	209	95
減価償却費	72	87	103	326	682	714
研究開発費	1	1	6	11	85	183
従業員数 (正社員) (人)	126	152	191	265	373	443

業績推移

(百万円)	2012年12月期	2013年12月期	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期
売上高						
ウエーハ事業	1,433	3,347	4,414	5,107	7,144	9,513
半導体生産設備 の買収・販売	—	—	—	372	1,611	1,395
その他	—	127	151	282	93	94
セグメント利益						
ウエーハ事業	△31	916	1,444	1,386	1,718	3,461
半導体生産設備 の買収・販売	—	—	—	135	221	129
その他	—	27	61	29	66	67
セグメント資産						
ウエーハ事業	994	1,337	5,040	6,993	5,620	8,148
半導体生産設備 の買収・販売	—	—	—	42	1,132	1,300
その他	—	396	382	533	556	532

主要財務諸表

(百万円)	2012年12月期*	2013年12月期*	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期
資産の部						
流動資産	745	1,811	2,759	3,892	5,525	7,625
現金及び預金	56	397	1,190	1,842	1,952	3,243
受取手形及び売掛金	363	681	696	970	2,727	3,141
商品及び製品	142	396	376	346	361	463
固定資産	248	508	4,064	5,845	5,333	4,843
有形固定資産	233	461	3,918	5,667	5,152	4,674
無形固定資産	7	19	15	29	23	19
投資その他資産	8	27	130	148	158	149
資産合計	994	2,320	6,823	9,737	10,859	12,468
負債の部						
流動負債	391	960	2,292	2,295	3,000	3,384
支払手形及び買掛金	116	138	151	186	283	398
有利子負債	17	136	827	1,216	1,537	1,275
固定負債	478	709	2,934	4,798	4,317	3,291
長期借入金	426	615	2,925	4,079	3,620	2,767
負債合計	869	1,670	5,227	7,093	7,317	6,676
純資産の部						
純資産	124	649	1,596	2,644	3,541	5,792
負債・純資産合計	994	2,320	6,823	9,737	10,859	12,468

*単独決算

当該資料に記載された内容は、一般的に認識されている経済情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営を取りまく様々な環境の変化により、予告なしに変更される可能性があります。

本発表において提供される資料ならびに情報の中には「見通し情報」が含まれております。これらの情報は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実際には異なる結果となる不確実性を含んでおります。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。